

Israel Monthly Trends

2025年11月

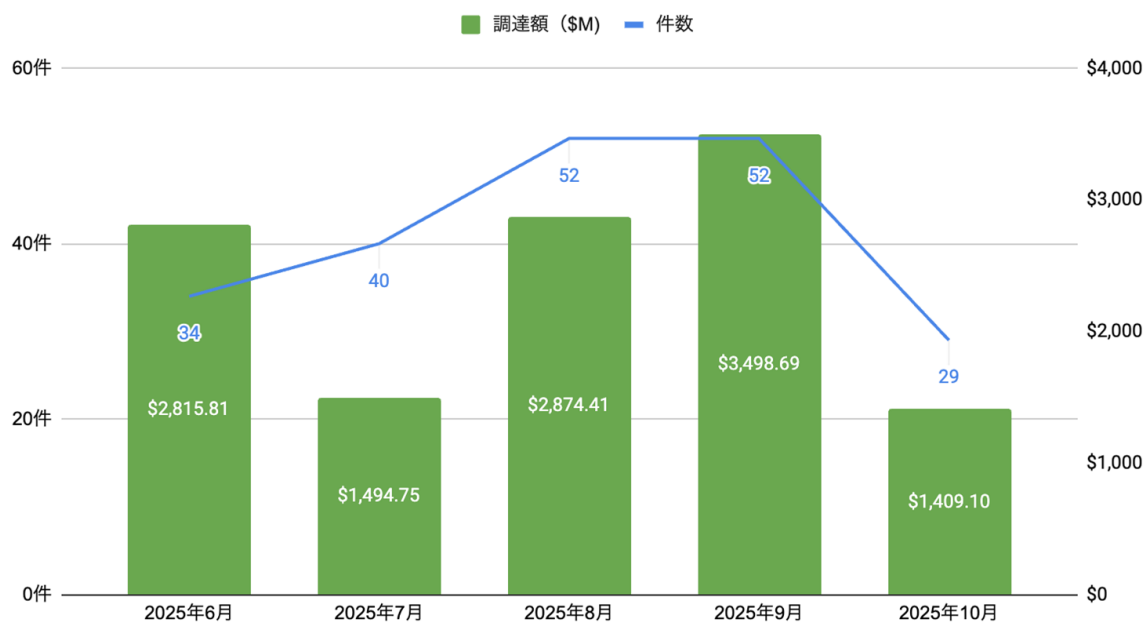
目次

1. イスラエルの現在の状況_11月	p.2
2. 今月の注目テーマ：半導体	p.3
3. 半導体に関連するスタートアップ	p.4

1. イスラエルの現在の状況_11月

2025年9月16日から2025年10月15日におけるスタートアップへの資金調達動向は、案件数が29件、調達総額は14億910万ドルであった。前回（8月16日から9月15日）の資金調達に比べて、案件数と調達総額はともに減少した。

イスラエル・ハイテク企業 月別資金調達推移



出典：IVC Data（2025年10月16日アクセス）、Jakore作成

本レポートの毎月のデータ収集期間は、前月16日から当月15日までとなる。

2025年9月後半から10月前半にかけては、エンタープライズソフトウェア・インフラ分野が引き続き市場を牽引した。Pagaya社がデット・ファイナンスで4億ドルを調達し、Island社がセカンダリー・ディールで2億7,500万ドル、Tipalti社がデット・ファイナンスで2億ドル、Kodiak Robotics社がPIPE（私募による上場企業への投資）で1億4,500万ドルを確保した。これらの大型案件が市場全体の資金流入を支えた形である。

2. 今月の注目テーマ：半導体

イスラエルでは半導体産業が国家競争力を支える戦略的柱となっており、生成AIや大規模言語モデル（LLM）との融合によって急速な技術革新を遂げている。Intel社やNvidia社などの多国籍企業が研究拠点を拡充し、Hailo社やProteanTecs社などのスタートアップがAIアクセラレータやEDA分野で成果を上げている。

主要な取り組みと成果

イスラエルは「スタートアップ国家」として、半導体とAIを基軸に産業構造を再定義している。同国のエコシステムは、研究開発拠点を持つグローバル企業、先端スタートアップ、大学研究機関、政府支援の四層構造で形成され、技術革新のスピードが際立っている。Intel社のハイファ研究所を中心にスマートファブ化を推進し、Nvidia社は7拠点・5,000人規模の研究体制でデータセンター向けプロセッサを開発している。Google社もAIチップ設計に特化したR&Dを拡充し、文書基盤モデルや会話型AI等のLLM活用、脅威管理、量子回路コンパイラの研究をするなど、国際企業の存在感が高い。

一方、Hailo社やSpeedata社、ProteanTecs社などのイスラエル発スタートアップが、AIアクセラレータ、EDA最適化、チップ健全性モニタリングといった分野で世界的評価を得ている。特にHailo社はエッジ向けAIプロセッサを商用化し、NeuReality社はSamsung Ventures社やSK Hynix社の出資を受けるなど、産業連携も進展している。学術面ではTechnionやTel Aviv UniversityがVLSI設計とAI融合教育を強化し、Weizmann研究所はサブミクロン構造や量子デバイスの研究で基盤を支える。さらに政府主導の「National AI Initiative」は10億シェケル規模（約2億7,000万ドル）の投資を通じ、LLM応用を含む次世代設計力を国家的に育成している。

こうした動きは日本側との技術連携とも親和性が高く、今後の協業機会の拡大が期待されている。イスラエルのLLM技術をフォトマスク設計の自動化や欠陥予測、パッケージング最適化、材料探索、IP保護に応用する構想が進められており、製造効率と品質保証の高度化を同時に実現する事例として注目されている。さらに、LLMを活用した特許分析や知財創出支援の取り組みも期待されており、日本の半導体再興に向けた戦略的連携の重要性が高まりつつある。

今後の展望

今後は、イスラエルが得意とするAIアクセラレータや専用チップ設計力と、日本の材料・製造技術の融合により、共同開発型の高効率半導体製造モデルが形成される見通しである。学際的研究の深化と産業界の統合がさらに進むことで、両国はマイクロエレクトロニクスの次世代基盤を共創する段階に入ると考えられる。

出典：<https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/israel-semiconductor-market/>

3. 半導体に関連するスタートアップ

- **ProteanTecs Ltd.**

(<https://www.proteantecs.com/>)



ProteanTecs社は、半導体チップ内部に組み込む「On-Chip Monitoring」技術を提供する企業である。動作中のチップから得られる電氣的・熱的データを機械学習で解析し、性能劣化や故障予兆を高精度に検知できる。クラウド分析基盤「deep data analytics platform」を通じて設計段階から実装・運用まで一貫した品質保証を可能にし、自動車・データセンター・通信機器など高信頼性が求められる分野で採用が拡大している。

- **PCB Technologies Ltd.**

(<https://www.pcb-technologies.com/>)



PCB Technologies社は、プリント基板とアセンブリ製造を手掛ける主要メーカーである。高密度多層基板（HDI）やリジッド・フレックス基板、RF・高周波対応基板を航空宇宙、防衛、医療、通信など多分野に供給している。自社クリーンルームを備え、設計から試作・小ロット量産まで短納期で対応できる点が強みである。2024年には検査装置を更新し、車載電子およびパワーモジュール向け需要に対応している。

- **VisIC Technologies Ltd.**

(<https://visic-tech.com/>)



VisIC Technologies社は、GaN（窒化ガリウム）ベースの高効率パワートランジスタを開発・製造する企業である。独自の「D³GaN」構造により高電圧・高周波数動作を両立し、EV用インバータや急速充電器、産業用電源装置に採用されている。従来のSiやSiCデバイスに比べてスイッチング損失を低減し、システム効率を大幅に向上させる点が特徴である。2025年には台湾のTSMCと製造提携を結び、量産体制を強化。欧州OEM各社との共同開発も進んでおり、次世代EV向けGaN市場を牽引している。